



## 第3回研究会

### 3DHIアライアンス第三回研究会

12:45 開場

13:00 ~ 14:00 「生成AIの急激な拡大に対応する半導体パッケージの役割とロードマップ」  
株式会社SBRテクノロジー 代表取締役 西尾 俊彦 氏

14:00 ~ 15:00 「エポキシ樹脂接着剤およびウレタン系接着剤の構造と物性にかかわる界面物理化学」  
九州大学先導物質化学研究所 准教授 小椎尾 謙 氏

15:00 ~ 15:15 休憩

15:15 ~ 16:15 「世界半導体市場と日本が取るべき戦略」  
グロスバーグ合同会社 代表 大山 聡 氏 (オンライン)

16:15 ~ 17:15 「チップレット時代における半導体パッケージ革命」  
Rapidus株式会社 専務執行役員 3Dアセンブリ本部長 折井 靖光 氏

17:15 ~ 17:25 「3DHI会員様への連絡事項について」  
3DHI事務局長 島内 秀 氏

17:25 ~ 17:40 「名刺交換会 (会場のみ)」